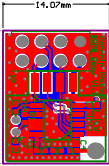
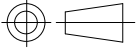


1	2	3	4																																																																								
<div>CHECK LIST</div> <table><tr><td>结构工程师核对内容</td><td>否</td><td>是</td></tr><tr><td>1. PCB中是否所有器件都有3D模型</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2. 是否有生成PCB的3D模型给结构进行装配</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3. 结构是否确认所有器件与外壳不干涉</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4. PCB板厚、外形及开孔公差是否满足要求</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5. PCB板厚、外形公差特殊要求是否标出</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3"></td></tr><tr><td>硬件工程师核对内容</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1. 原理图网络和PCB网络是否完全匹配</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2. 最小线宽是否大于或等于0.15mm</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3. 所有电源网络走线是否有双过孔</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4. 所有大于100mA电流的走线是否有双过孔</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5. 布局是否合理，后焊间距是否为1mm</td><td></td><td></td></tr><tr><td>6. 电源回路，地回路是否足够宽和最短</td><td></td><td></td></tr><tr><td>7. 过孔属性是否全为盖油</td><td></td><td></td></tr><tr><td>8. PCB上是否铜仔片或导电硅胶按键</td><td></td><td></td></tr></table>			结构工程师核对内容	否	是	1. PCB中是否所有器件都有3D模型			2. 是否有生成PCB的3D模型给结构进行装配			3. 结构是否确认所有器件与外壳不干涉			4. PCB板厚、外形及开孔公差是否满足要求			5. PCB板厚、外形公差特殊要求是否标出						硬件工程师核对内容			1. 原理图网络和PCB网络是否完全匹配			2. 最小线宽是否大于或等于0.15mm			3. 所有电源网络走线是否有双过孔			4. 所有大于100mA电流的走线是否有双过孔			5. 布局是否合理，后焊间距是否为1mm			6. 电源回路，地回路是否足够宽和最短			7. 过孔属性是否全为盖油			8. PCB上是否铜仔片或导电硅胶按键			<table><tr><td>板材</td><td>FR-4</td><td>器件</td><td>14</td></tr><tr><td>板层</td><td>双面</td><td>网络</td><td>11</td></tr><tr><td>工艺</td><td></td><td>过孔</td><td>76</td></tr><tr><td>铜厚</td><td>35u</td><td>孔</td><td>87</td></tr><tr><td>颜色</td><td>绿色</td><td>焊盘</td><td>45</td></tr><tr><td>拼板 量产</td><td colspan="3">由板厂按最优方案拼板后，将拼板文件电子档发给研发和工艺确认并存档</td></tr></table>	板材	FR-4	器件	14	板层	双面	网络	11	工艺		过孔	76	铜厚	35u	孔	87	颜色	绿色	焊盘	45	拼板 量产	由板厂按最优方案拼板后，将拼板文件电子档发给研发和工艺确认并存档		
结构工程师核对内容	否	是																																																																									
1. PCB中是否所有器件都有3D模型																																																																											
2. 是否有生成PCB的3D模型给结构进行装配																																																																											
3. 结构是否确认所有器件与外壳不干涉																																																																											
4. PCB板厚、外形及开孔公差是否满足要求																																																																											
5. PCB板厚、外形公差特殊要求是否标出																																																																											
硬件工程师核对内容																																																																											
1. 原理图网络和PCB网络是否完全匹配																																																																											
2. 最小线宽是否大于或等于0.15mm																																																																											
3. 所有电源网络走线是否有双过孔																																																																											
4. 所有大于100mA电流的走线是否有双过孔																																																																											
5. 布局是否合理，后焊间距是否为1mm																																																																											
6. 电源回路，地回路是否足够宽和最短																																																																											
7. 过孔属性是否全为盖油																																																																											
8. PCB上是否铜仔片或导电硅胶按键																																																																											
板材	FR-4	器件	14																																																																								
板层	双面	网络	11																																																																								
工艺		过孔	76																																																																								
铜厚	35u	孔	87																																																																								
颜色	绿色	焊盘	45																																																																								
拼板 量产	由板厂按最优方案拼板后，将拼板文件电子档发给研发和工艺确认并存档																																																																										
A			A																																																																								
<div><div><div><div><div>14.07mm</div><div>12.61mm</div></div><div></div></div><div><div>←板厚: 1.00 ± 10%</div></div></div></div>																																																																											
B			B																																																																								
C			C																																																																								
D			D																																																																								
<div><div><div><div><div></div><div>外型公差: ± 0.1mm 板厚公差: 0.4-0.8 ± 0.08mm 1.0-2.0 ± 10% V-CUT对位精度: ± 0.1mm V-CUT深度: 1/3板厚</div></div><div><table><tr><td colspan="4">上海磐启微电子有限公司</td></tr><tr><td>项目编码</td><td></td><td>原理设计</td><td></td><td>日期</td><td></td></tr><tr><td>项目名称</td><td></td><td>PCB 设计</td><td></td><td>日期</td><td></td></tr><tr><td>PCB 名称</td><td>PAN297LBW</td><td>结构设计</td><td></td><td>日期</td><td></td></tr><tr><td>PCB 编码</td><td></td><td>审 核</td><td></td><td>日期</td><td></td></tr><tr><td>图纸编号</td><td></td><td>批 准</td><td></td><td>日期</td><td></td></tr><tr><td>单 位</td><td>mm</td><td>版 本</td><td></td><td>图层</td><td>顶层</td><td>第 1 页</td><td>共 2 页</td></tr></table></div></div></div></div>				上海磐启微电子有限公司				项目编码		原理设计		日期		项目名称		PCB 设计		日期		PCB 名称	PAN297LBW	结构设计		日期		PCB 编码		审 核		日期		图纸编号		批 准		日期		单 位	mm	版 本		图层	顶层	第 1 页	共 2 页																														
上海磐启微电子有限公司																																																																											
项目编码		原理设计		日期																																																																							
项目名称		PCB 设计		日期																																																																							
PCB 名称	PAN297LBW	结构设计		日期																																																																							
PCB 编码		审 核		日期																																																																							
图纸编号		批 准		日期																																																																							
单 位	mm	版 本		图层	顶层	第 1 页	共 2 页																																																																				
1	2	3	4																																																																								